

お客様各位

平成29年5月吉日

株式会社 岡本工作機械製作所

代表取締役社長

石井 常路

## eX-tech2017 出展のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は2017 マイクロエレクトロニクスショーでの特別企画として開催される eX-tech2017 (エクステック 2017) にポスター出展する運びとなりました。

今回は、ウェーハレベルパッケージ (FOWLP, WLCSP) 用の樹脂、Cu およびシリコン等の複合材料研削手法、ポンプ用 BG テープ基材等を独自の手法で平坦化する研削装置 (SGL6) とその技術、およびシリコン貫通電極 (TSV) 用に新たに開発した研削・めっき・エッチング・洗浄複合装置 (TSV300i) をポスター展示いたします。両技術では、弊社が独自に開発した異種材料の同時研削技術を導入することで、従来不可能であった硬軟複合材料や軟々複合材料を高面品位かつ高平坦に同時研削できる技術をご紹介します。TSV ウェーハの薄層化装置は現在、国立研究開発法人・科学技術振興機構 (JST) の A-STEP ステージ III (NexTEP-A) に採択され、東京オリピック開催中の 2020 年の完成を目指して開発を進めております。

大変お忙しい中とは存じますが、何卒お誘いあわせの上ご来場頂けます様、心よりお待ち申し上げます。

敬具

記

日時: 2017年6月7日(水)~9日(金)10:00 - 17:00

場所: 東京ビックサイト 東8ホール

小間番号: マイクロエレクトロニクスショー2017内 eX-tech2017 [8B-10](#)

ポスター展示: ・ウェーハレベルパッケージ用薄層化研削技術と装置 (SGL6)  
・TSV 薄層化用研削・めっき・エッチング・洗浄複合機 (TSV300i)  
・ハイパンプウェーハの高平坦・薄層化技術 (GNX200B)

[ お問い合わせ先 ] 株式会社岡本工作機械製作所 技術開発本部 開発部

〒379-0135 群馬県安中市郷原 2993 [TEL:027-385-5112](tel:027-385-5112) Fax:027-385-5122

担当: 三井、伊東、山本 [URL : http://www.okamoto.co.jp/](http://www.okamoto.co.jp/)

